**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2019-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国泰君安 陈飞达  同威投资 谭琳  同威投资 刘弘 |
| 时间 | 2019年3月8日上午10:00 |
| 地点 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司会议室 |
| 上市公司接待人员  姓名 | 董事会秘书：钟辉先生  证券事务代表：杨晓芬女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、董事会秘书钟辉先生简要介绍公司发展历程、业务发展、目前基本情况以及公司发展战略。  二、互动交流  交流问题如下：  **Q1：2018年公司各类设备的销售占比情况如何？**  A1：2018年度公司设备类产品营业收入占比达96.23%。邦定、贴合设备一直是公司的主打设备，2018年公司邦定设备、贴合设备销售额合计占80%以上,其中邦定和贴合设备基本各占一半。另一类销售额占比较大的是华为向公司采购的自动化设备，总额占比超过10%。  **Q2：公司一般采用什么定价策略？**  **A2:**公司根据客户需求进行研发生产，所产设备是非标准化设备，一般采用成本加成的定价策略，有效确定公司利润空间。在后段组装设备生产领域，相较于国外设备生产厂商，国内设备厂商能更有效降低成本，以价格优势抢占国内市场，能实现较好的营业利润。  **Q3：公司2019年度切入半导体领域会有新的利润增长点吗？**  A3：公司在加大研发投入的同时，尝试进入新领域半导体领域，公司论证布局半导体行业已有多年。在2018年度公司就日本全资子公司Liande·J·R&D株式会社研发团队积极进行着半导体封装设备的研发。目前研发成果已有半导体倒装设备和SFO光学系统检测机设备,均处于样机调试阶段，上述设备也将于2019年3月20日至3月22日于慕尼黑上海电子展展出，后期也将与客户开展商务洽谈。若进展顺利,我们相信这一新产品能成为公司未来新的增长点之一。  **Q4：公司的可转债募集资金使用在哪里？**  A4：根据公司的长期规划，可转债募集资金将使用在公司竞拍取得的深圳市龙华区观湖街道宗地号A909-0154土地上用于建设公司总部研发基地。  **Q5：请问公司未来发展的重点领域是什么？**  **A5：**公司未来发展规划主要集中在模组组装领域，其中新增重点大尺寸面板模组组装、新型半导体柔性显示、3D 曲面显示，AOI检测领域、面板中前段制程设备研发和半导体生产设备研发（半导体封装和测试设备）。在行业领域来说，我们希望2019年能够进入汽车领域获得更多的市场机会。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019-03-08 |